

泉州市科学技术局 泉州市财政局文件 泉州半导体高新技术产业园区管理委员会

泉科〔2026〕52号

泉州市科学技术局 泉州市财政局 泉州半导体 高新技术产业园区管理委员会关于开展 2026年集成电路设计补助资金 申报工作的通知

各县（市、区）科技管理部门、财政部门，泉州半导体高新技术产业园区管委会各分园区办事处：

根据《泉州市人民政府办公室关于印发加快泉州市数字经济发展若干措施的通知》（泉政办规〔2025〕18号）文件精神，经研究，决定开展2026年集成电路设计补助资金申报工作，请

你们严格按照本通知要求，认真做好项目申报相关工作。

泉州市科学技术局

泉州市财政局

泉州半导体高新技术产业园区管理委员会

2026年5月19日

2026 年集成电路设计企业发展专项资金 项目申报指南

为贯彻落实《泉州市人民政府办公室关于印发加快泉州市数字经济发展若干措施的通知》（泉政办规〔2025〕18号）文件要求，推动我市集成电路设计产业发展，制定本申报指南。

一、支持对象

注册地、经营场所均在泉州市行政辖区内的，具有独立法人资格，专业从事集成电路领域研发设计、制造、封测、装备和材料研发生产、公共技术服务的企业（单位），且 2025 年度企业研发费用总额不低于 100 万元，占企业销售（营业）收入（主营业务收入与其他业务收入之和）总额的比例不低于 6%。

二、支持方向

（一）MPW、流片补助

（1）补助标准

1.采用多项目晶圆（MPW）进行产品研发，按 MPW 直接费用 的 80%给予补助；首次工程流片项目按流片费用的 50%给予补助。单一企业每年补助总额不超过 200 万元。

2.补助资金由市、县两级财政按 1:1 比例分摊。

（2）申报材料

- 1.《集成电路设计补助资金申报书（设计企业）》。
- 2.芯片设计版图缩略图、产品外观照片。

3.MPW/首次工程流片证明，如 MPW/流片合同、发票、付款凭证及银行回单、结算明细表等（境外加工的需提供报关单位或委外加工证明），申报工程流片补助的，还需提供该产品为首次工程流片的证明材料。

4.企业职工名册、以及 2025 年度最后 3 个月的企业职工社会保险缴纳证明等相关材料。

5.2025 年度企业集成电路设计销售（营业）收入、研究开发费用证明材料，会计师事务所出具的专项审计报告（审计内容包含企业 2025 年销售收入、研发费用、MPW 直接费用/首次工程流片费用，要求详见其他事项第六条）。

6.企业营业执照副本复印件（加盖公章）。

7.无失信被执行人员、无涉黑涉恶承诺书（加盖公章）。

8.项目申报承诺书（加盖公章）。

备注:材料要求及装订顺序详见附件 1,外文材料需提供翻译件。

（二）购买设计工具、IP 等补助

（1）补助标准

1.集成电路设计企业购买集成电路布图设计专有权开展高端芯片研发，按集成电路布图设计专有权购买直接费用的 50% 给予补助，单一企业每年补助总额不超过 200 万元。购买第三方 IC 设计平台提供的“IP 复用、共享设计工具软件或测试与分析”服务，按实际购买服务费用的 55% 给予补助，单一企业每年补助

总额不超过 150 万元。

2. 补助资金由市、县两级财政按 1:1 比例分摊。

(2) 申报材料

1. 《集成电路设计补助资金申报书（设计企业）》。

2. 购买“集成电路布图设计专有权”证明（合同、发票及付款凭证、结算明细表）；购买设计工具必要性说明（包括工具用途及作用概述、供应商行业地位概述、采购工具必要性概述），EDA 正版软件购买证明、使用证明（合同、发票及付款凭证、结算明细表）；购买“IP 复用、共享设计工具软件或测试与分析”服务证明（合同、发票及付款凭证、结算明细表）。

3. 企业职工名册、以及 2025 年度最后 3 个月的企业职工社会保险缴纳证明等相关材料。

4. 2025 年度企业集成电路设计销售（营业）收入、研究开发费用证明材料，会计师事务所出具的专项审计报告（审计内容包含企业 2025 年销售收入、研发费用、集成电路布图设计专有权购买直接费用/购买第三方 IC 设计平台提供的“IP 复用、共享设计工具软件或测试与分析”服务实际费用，要求详见其他事项第六条）。

5. 企业营业执照副本复印件（加盖公章）。

6. 无失信被执行人员、无涉黑涉恶承诺书（加盖公章）。

7. 项目申报承诺书（加盖公章）。

备注:材料要求及装订顺序详见附件 1,外文材料需提供翻译件。

三、申报流程

(一) 企业申报。申报单位根据通知要求,于 2026 年 7 月 18 日前将纸质和电子文档申报材料(一式三份)加盖单位公章后报送至属地科技管理部门,并对申报材料的真实性、完整性负责。申报材料需提供目录、标注页码,按顺序装订成册。

(二) 审核推荐。属地科技管理部门对申报材料的真实性、完整性与规范性进行初审及现场核实,汇总填报《2026 年集成电路设计补助资金申报企业初审推荐名单》(详见附件 2),会同属地财政部门于 2026 年 7 月 25 日前正式行文向市科技局、泉州半导体高新区管委会推荐(企业申报材料随文提交至泉州半导体高新区管委会,交通科研楼 A 栋 5105),并抄送市财政局。

(三) 项目评审。泉州市科技局和泉州半导体高新区管委会组织专家对申报项目开展评审。

(四) 结果公示。通过评审的项目名单在泉州市科技局、泉州半导体高新区管委会网站公示,公示期 5 个工作日。

四、其他事项

(一) 企业所申报项目应为已执行项目,申报奖补所提供的发票等付款凭证需发生在 2025 年度,并提供会计师事务所出具的专项审计报告(封面需有防伪条形编码)。同一单位的同一项目不得多头申报,也不能在本扶持资金任一子类中重复申报。

(二)所有符合条件的项目申报资金总额超过本年度市级专项补助资金预算总额时，实际兑现资金额度按比例压缩核减。

(三)企业应对申报材料的真实性、完整性负责，如以虚假材料申报，三年内不得再次申报，并将对社会进行公布，由相关部门取消或收回已拨付的扶持资金。

(四)根据《中共泉州市委办公室泉州市人民政府办公室印发<关于加快推进失信被执行人信用监督、警示和惩戒机制建设的实施意见>的通知》(泉委办发〔2017〕7号)等文件精神，企业(机构)及其法定代表人、实际控制人等被列入失信被执行人的，不予扶持。根据扫黑除恶专项斗争相关要求，涉黑涉恶的企业不予扶持。

(五)专项资金所需出具专项审计报告的将由泉州半导体高新区管委会选定会计师(审计)事务所审计后出具，具体审计单位、时间另行通知。

(六)专项资金必须专款专用，任何单位不得以任何理由、任何形式截留挪用。对违反规定的，依照国家有关规定进行处理。

联系人：

泉州半导体高新区管委会，颜厥智，0595-28383339

市科技局高新科，谢惠阳，0595-22579329

附件：1.集成电路设计补助资金申报书(设计企业)

2.2026年集成电路设计补助资金申报企业初审推荐名单

附件 1

集成电路设计补助资金申报书

（设计企业）

申报单位（公章）： _____

联系人： _____

联系电话： _____

申报日期： _____

申报项目： 新产品批量验证的流片（工程流片）费用

购买集成电路布图设计专有权、购买第三方设计平台服务

填报说明

1.资金支持对象：在泉州区域内注册成立，从事集成电路功能研发、设计、应用及相关服务的的法人单位。

2.申报书内容及附件是集成电路设计补助资金评审的主要依据，须严格按照规定格式和栏目要求填写，内容真实、准确、全面，严禁弄虚作假。

3.申报单位须按照资金申报要求提供相关证明材料复印件，附件需每页加盖公章。

4.申报书及附件须编制目录页码，装订成册，申报书封面、骑缝加盖公章。

一、企业基本情况表

企业名称				所属园区		
注册地址						
办公地址				成立时间		
统一社会信用代码				邮政编码		
法定代表人	姓名			职务		
	身份证号码			手机号码		
	E-mail					
企业负责人	姓名			职务		
	手机号码			E-mail		
企业联系人	姓名			职务		
	手机号码			传真		
	E-mail					
注册资本 (万元)			其中：外资（含港澳台）比例	%		
工商注册 企业类型	01.国有企业 02.集体企业 03.股份合作企业 04.联营企业 05.有限责任公司 06.股份有限公司 07.私营企业 08.港、澳、台商投资企业 09.外商投资企业 10.其他企业					
股权结构 (前三名)	股东 名称	股东性质 (外资、 内资)	出资 金额 (万元)	股权 比例 (%)	出资 方式	是否 创始人

主要财务指标	总资产 (万元)	2025 年度销售 (营业) 收入 (万元)		毛利率 (%)	净利润 率 (%)	近三年 净利润 平均 增长率
项目核心团队 简介						
企业概况						
融资情况						
经营范围	(须从事集成电路功能研发、设计及相关服务)					
产业情况	核心产品和技术					
	核心技术来源					
	行业地位					
	产品市场估计					

	细分领域发展趋势	
	主要竞争对手	国内：
		国外：
企业分公司（或子公司）分布情况		
获得的奖励及荣誉称号		
企业承担的主要工程项目		
上市计划		

二、企业研发和创新能力表

人员构成	职工总人数	人	研发人员比例	%
	大学专科以上学历人员比例	%	具备集成电路研发背景的人员比例	%
2025 年度研发投入金额		万元	研发投入占企业销售（营业）收入的比例	%
申报项目投入及申请补助情况	多项目晶圆（MPW）		2025 年投入费用（不含税）	万元
			申请补助金额	万元
	首次工程流片（新产品批量验证的流片）		2025 年投入费用（不含税）	万元
			申请补助金额	万元
	购买集成电路布图设计专有权		2025 年投入费用（不含税）	万元
			申请补助金额	万元
	购买第三方 IC 设计平台提供的“IP 复用、共享设计工具软件或测试与分析”服务		2025 年投入费用（不含税）	万元
			申请补助金额	万元
	企业专利情况		已申请发明专利数	项
			已获得授权发明专利数	项
已申请集成电路芯片设计专利数			项	
软件著作权			项	
布图设计专有权			项	

用于集成电路设计的生产经营场所、软硬件设施等开发环境（如 EDA 工具、合法的开发工具等），以及与服务相关的技术支持环境	
--	--

三、工程流片（MPW 服务）申报情况证明材料

（一）芯片设计版图缩略图、产品外观照片

（二）流片情况汇总表

序号	产品名称	申报类型 (工程流片、 MPW 服务)	代工 企业	合同签订 时间	数量 (片)	合同金额 (万元)	记账凭证号	发票号	发票时间	发票金额 (万元)	不含税 金额(万 元)
1											
			
2											
			
...											
合计金额（万元）											

注：相关证明材料需以“产品名称”为分类依据，按照“合同 1、记账凭证 1、银行回单 1、发票 1、合同 2、记账凭证 2、银行回单 2、发票 2.....”的顺序依次装订。

四、购买集成电路布图设计专有权、第三方 IC 设计平台服务申报情况证明材料

(一) 购买布图设计专有权、第三方 IC 设计平台服务的必要性说明

(二) 购买布图设计专有权、第三方 IC 设计平台服务的情况汇总表

序号	产品名称	申报类型 (布图设计、第三方服务)	对方企业	合同签订时间	数量 (项)	合同金额 (万元)	记账凭证号	发票号	发票时间	发票金额 (万元)	不含税金额 (万元)
1											
			
2											
			
...											
合计金额 (万元)											

注：相关证明材料需以“产品名称”为分类依据，按照“合同 1、记账凭证 1、银行回单 1、发票 1、合同 2、记账凭证 2、银行回单 2、发票 2.....”的顺序依次装订。

五、企业职工名册、以及 2025 年度最后 3 个月的企业职工社会保险缴纳证明等相关材料

六、2025 年度企业集成电路设计销售（营业）收入、研究开发费用证明材料，会计师事务所出具的专项审计报告

七、企业营业执照副本复印件（加盖公章）

八、无失信被执行人员、无涉黑涉恶承诺书，项目申报承诺书（模板如下）

无失信被执行人员、无涉黑涉恶承诺书

1.本单位法定代表人、实际控制人、董事、监事、高级管理人员名单（高级管理人员包括公司的经理、副经理、财务负责人、上市公司董事会秘书和公司章程规定的其他人员）：

序号	姓名	身份证号	职务
1			
2			
3			
4			
5			
...			

2.以上名单真实完整，本单位及以上名单人员未被列为失信被执行人，本单位无涉黑涉恶行为，以上名单人员未涉黑涉恶行为，如有不实，本单位愿意承担一切法律责任。

填报单位（公章）：

统一社会信用代码：

年 月 日

项目申报承诺书

我单位对如下事项郑重承诺：

一、按照规定组织申报材料，并对所有申报项目所有材料（包括文字、文件、数据、图片、合同和凭证等）的真实性负责；

二、遵守国家相关法律法规，上年度未发生偷漏税、拖欠职工工资及欠缴社会保险费、较大以上生产安全事故、重特大环境污染事件和重大产品质量安全事故等行为；

三、按照规定程序申报，对涉及扶持资金管理的相关部门及人员，不采取吃请、馈赠、贿赂等不正当手段；

四、承担应尽的社会责任，确保按期实现项目申报中承诺的社会经济发展目标。

如有违反上述承诺，我单位愿承担一切责任。

申报单位（公章）：

法人代表（签字）：

年 月 日

附件 2

2026 年集成电路设计补助资金申报企业初审推荐名单

填报单位：（盖章）

单位：万元

序号	申报企业	多项目晶圆 (MPW) 申请补 助金额	首次工程流片 申请补助金额	集成电路布图设计专 有权申请补助金额	第三方 IC 设计 服务申请补助金 额	合计
1						
2						
....						

填报人：

联系方式：

